



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2022 年第二季自结财务报告

2022 年 7 月 26 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(26)日公告 2022 年第二季自结财务报告。

2022 年第二季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 52.97 亿元，较前季减少 5%，较去年同期减少 14%
- ◆ 本季合并毛利率为 30.2%，较前季减少 0.4 个百分点；本季营业净利率为 14.1%，较前季减少 2.3 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 7.47 亿元，较前季减少 18%，较去年同期减少 47%
- ◆ 本季税后净利为新台币 5.44 亿元，较前季减少 31%，较去年同期减少 41%；每股盈余为新台币 1.52 元，前季为新台币 2.08 元

2022 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第三季营收预计较前一季下滑 mid-twenties 百分比。
- ◆ 第三季毛利率预计约为 low-twenties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“稳懋第二季合并营收为新台币 52.97 亿元，季成长率及年成长率分别为 -5% 及 -14%。受到产能利用率继上一季之后持续下滑到 60% 的影响，第二季营业毛利率及营业净利率分别为 30.2% 及 14.1%，EPS 为新台币 1.52 元。综观第二季产品组合，Wi-Fi PA、Infra 及 3D 感测相关之光通讯业务均有不同幅度的成长，其中，成长最多的 3D 感测如同以往逐渐摆脱第一季的传统淡季，其次是 Infra 及 Wi-Fi PA 的营收都超越第一季的水平，但是受到中国智能型手机市场库存持续调整的影响之下 Cellular PA 营收如同预期呈现明显的下滑。

尽管中国智能型手机库存调整从第一季就开始，但俄乌战争于第一季开打至今尚未结束，加上第二季中国进入严格的防疫封控，不但影响中国当地的消费需求，也导致了原物料短缺及全球供应链的中断，推升了原已居高不下的通膨，更进一步影响终端需求，以致于智能型手机库存去化的速度似乎至今仍然缓慢。在整体手机需求透明度偏低的情况之下，尽管美系高阶智能型手机客户仍然依照过往的步调下单备货，但在整体安卓(Android)手机一片库存过高声中，正悄悄的为今年下半年需求投下变量。在此总体经济的逆境中，稳懋仍然秉持着继续投入研发量能，开发新应用客户及所需技术，因为稳懋相信今年大环境的变化只是短期的现象，5G 的大趋势持续不变，相关基础建设及低轨卫星布建都未臻完备，Wi-Fi 6/6E/7 尚在向前推进当中，光通讯及光感测相关应用也处萌芽阶段，稳懋乐观看待产业长期的成长趋势。

展望第三季，持续受到 Android 智能型手机市场库存调整及大环境的不确定性影响，营收预计将较前一季下滑 mid-twenties 百分比，毛利率预期落在 low-twenties 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体制程技术：异质界面双极性晶体管(HBT)和应变式异质界面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。